

海通证券股份有限公司关于峰昭科技（深圳）股份有限公司

2024 年度持续督导年度跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：峰昭科技
保荐代表人姓名：严胜、孙允孜	被保荐公司代码：688279

经中国证券监督管理委员会《关于同意峰昭科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕457号）同意注册，峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 23,090,850 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 82.00 元，募集资金总额为人民币 189,344.97 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 172,846.18 万元。本次发行证券已于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日。

在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2024 年度持续督导情况报告如下：

一、2024 年保荐机构持续督导工作情况

项 目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。
2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期间	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议

项 目	工作内容
的权利义务签订持续督导协议。	明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。	保荐机构已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
4、持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。	保荐机构已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。	保荐机构已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。
6、督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐机构已督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。
7、上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。 上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
8、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐机构已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
9、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项，核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。	保荐机构已持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况。本持续督导期间，上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。
10、重点关注上市公司是否存在如下事项：	本持续督导期内，上市公司未出现该等事项。

项 目	工作内容
（一）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； （三）可能存在重大违规担保； （四）资金往来或者现金流存在重大异常； （五）上交所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。 出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查，并在现场核查结束后 15 个交易日内披露现场核查报告。	
11、关注上市公司股票交易严重异常波动情况，督促上市公司及时按照上市规则履行信息披露义务。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
12、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件； （二）资产被查封、扣押或冻结； （三）未能清偿到期债务； （四）实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； （五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项； （六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
13、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化； （二）核心技术人员离职； （三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷； （四）主要产品研发失败； （五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现	2024 年 7 月，公司核心技术人员 SOH CHENG SU（苏清赐）先生因个人原因申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后，SOH CHENG SU（苏清赐）先生不再担任公司任何职务，同时公司新增认定李宝荣为核心技术人员。 保荐机构对公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员事项进行核查，并出具明确核查意见。

项 目	工作内容
具有明显优势的竞争者； （六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	
14、控股股东、实际控制人及其一致行动人出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对上市公司控制权稳定和日常经营的影响、是否存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）所持上市公司股份被司法冻结； （二）质押上市公司股份比例超过所持股份80%或者被强制平仓的； （三）上交所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
15、督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐机构已督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。
16、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。	保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议，于2024年8月14日和2025年3月17日至2025年3月31日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查，并出具关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
17、保荐机构发表核查意见情况。	2024年度，保荐机构发表核查意见具体情况如下： 2024年1月11日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于峰昭科技（深圳）股份有限公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的核查意见》； 2024年3月21日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于峰昭科技（深圳）股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见》； 2024年4月11日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于峰昭科技（深圳）股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》； 2024年4月24日，保荐机构发表《海通证券

项 目	工作内容
	股份有限公司关于峰昭科技（深圳）股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》《海通证券股份有限公司关于峰昭科技（深圳）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》《海通证券股份有限公司关于峰昭科技（深圳）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》《海通证券股份有限公司关于峰昭科技（深圳）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》； 2024 年 5 月 29 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于峰昭科技（深圳）股份有限公司差异化分红事项的核查意见》； 2024 年 6 月 7 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于峰昭科技（深圳）股份有限公司全资子公司拟购买房产的核查意见》《海通证券股份有限公司关于峰昭科技（深圳）股份有限公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的核查意见》《海通证券股份有限公司关于峰昭科技（深圳）股份有限公司变更募投项目实施地点及调整获取场地方式的核查意见》； 2024 年 7 月 4 日，《海通证券股份有限公司关于峰昭科技（深圳）股份有限公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员核查意见》。
18、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	无

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、研发风险

由于公司采用专用芯片设计路线，市场上没有与之相匹配的成熟可靠的 IP 内核与软件库可以直接授权使用，需要研发团队长时间的自主研发与经验积累，BLDC 电机驱动控制芯片基础研究难度较大，研发周期较长，开发成本较高。芯片设计研发能力建立在不同应用场景电机智能控制需求、对应电机控制算法、电机技术等三者结合的深度理解，需要芯片设计、算法架构、电机技术三方面研发力量深度融合，对复合型研发人才以及三方面技术力量协调融合提出了较高的要求；若公司无法对研发团队、研发人员、研发力量进行有效整合管理，导致无法顺应市场需求及时推出新的芯片产品，将对公司持续创新研发、产品迭代更新造成不利影响。

2、知识产权风险

公司通过持续不断的探索和积累，已形成了具有自主知识产权的专业核心技术和相关技术储备。专利作为研发成果的重要保护形式之一，帮助企业构建自身技术壁垒并对公司产品开发具有重要作用。若竞争对手或第三方采取恶意诉讼策略，阻滞公司市场拓展，或通过窃取公司知识产权非法获利，可能会对公司经营产生不利影响。

3、核心技术泄密风险

公司所处集成电路设计行业为典型的技术密集行业，核心技术是公司保持竞争优势的基础。公司尚有多项产品和技术正处于研发阶段，公司的经营模式也需向供应商提供核心技术资料等，不排除公司核心技术泄密风险。

4、人力资源不足及人才流失的风险

集成电路行业属于技术密集型和人才密集型产业，人力资源是企业的核心竞争

力之一。公司需要不断吸引优秀人才的加盟，因此公司对相关优秀人才的需求将愈加迫切。同时，随着集成电路行业竞争日益激烈，企业对人才争夺的加剧，公司的相关人才存在一定的流失风险。如果发生核心管理和技术人员大量流失或者因规模扩张导致人才不足的情形，很可能影响公司发展战略的顺利实施，并对公司的业绩产生不利影响。

5、电机控制专用芯片技术路线风险

公司竞争对手大多为境外知名芯片厂商；竞争对手大多采用通用 MCU 芯片的技术路线，一般采用 ARM 公司授权的 Cortex-M 系列内核；公司则坚持专用化芯片研发路线，形成完全自主知识产权的芯片内核 ME。公司与竞争对手共同受益于下游行业旺盛需求所带来的商机。若竞争对手利用其雄厚技术及资金实力、丰富客户渠道、完善供应链等优势，亦加大专用化芯片研发力度，公司可能面临产品竞争力下降、市场份额萎缩等风险。

（二）经营风险

1、供应商集中风险

公司产品的晶圆制造和封装测试等生产环节均由境内外行业领先的晶圆制造和封装测试厂商完成，公司与这些主要供应商保持着长期稳定合作关系。由于行业特性，各环节供应商集中度较高。若主要采购地区集成电路领域的贸易政策发生不利变化，或其主要原材料供应商或封测供应商的供货因各种原因出现中断或减少，或上述供应商大幅提高供货价格，或生产管理水平欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的产品出货、盈利能力造成不利影响。因此，公司面临一定程度的原材料供应及外协加工的风险。

2、经营模式风险

公司采用 Fabless 运营模式，主要从事芯片的设计及销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节交由晶圆制造厂商和封装测试厂商完成。鉴于公司未自建生产线，相关产品全部通过委外厂商加工完成，在产能上不具备自主调整的能力。若集成电

路行业制造环节的产能与需求关系发生波动将导致晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足，或受到贸易摩擦加剧等政策性影响导致上游供应商缩减甚至停止供货，公司产品的供应能力将受到直接影响，从而影响公司未来的业绩。

3、持续资金投入风险

集成电路设计行业是典型的科技、资金密集型行业，具有资金投入高、研发风险大的特点。公司为保持竞争力，需要在研发、制造等各个环节上持续不断进行资金投入。随着新产品制造工艺标准提高，公司流片费用将上涨；晶圆及封装测试作为公司产品成本的主要部分，持续性采购投入亦会对公司现金流提出较高要求。如果公司不能持续进行资金投入，不能进行前瞻性研究及产品迭代升级，则难以确保公司技术的先进性、工艺的国际性和产品的市场竞争力。

4、产品质量的风险

公司主要从事电机驱动控制专用芯片的研发和销售，产品广泛应用于家电、电动工具、计算机及通信设备、运动出行、工业与汽车等多个领域。电机驱动控制芯片行业需要不断注入技术力量，属于技术驱动型行业，行业进入壁垒也相对较高，芯片设计、制造、封装测试等各个环节均需要大量的技术研发和工艺积累，任一环节出现问题都会导致产品出现质量问题。随着行业内对芯片产品质量要求的不断提高，若在上述环节中发生无法预料的风险，可能导致公司产品出现质量问题，甚至导致客户流失、品牌美誉度下降，对未来公司业绩造成不利影响。

5、规模扩张导致的管理风险

随着公司业务的发展和募集资金投资项目的实施，公司的经营规模将会进一步扩张，这将对公司的经营管理、内部控制和财务规范等内部组织管理提出更高的要求。若公司的管理制度和管理体系无法满足经营规模扩大的需求，将会对公司的经营效率带来不利影响。

（三）财务风险

1、售价或毛利率波动风险

随着市场竞争加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术升级创新。若公司未能判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前，或公司未能有效控制产品成本，或公司产品市场竞争格局发生变化等导致公司发生产品售价下降、产品收入结构向低毛利率产品倾斜等不利情形，公司产品销售价格或毛利率存在下滑风险。

若全球芯片行业上游晶圆制造和封装测试等委外加工的产能紧张，投产周期延长，公司采购价格存在大幅上涨风险，公司在执行“成本+目标毛利率空间”的定价策略下，采购价格的增长将导致销售价格的上升，若销售价格涨幅不及采购价格涨幅，公司销售毛利率存在下滑风险。

2、存货跌价风险

由于公司业务规模增长，存货余额随着上升。如果公司未来下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，就有可能导致存货无法顺利实现销售，公司存货存在跌价风险。

（四）行业风险

1、产业政策风险

作为战略性产业，近年来国家出台系列政策推动行业发展，增强行业创新能力和国际竞争力。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，将对公司发展产生一定影响。

2、下游需求波动风险

公司的业务扩张主要受益于下游应用领域的终端产品市场的迅速增长。尽管公司下游应用市场种类繁多，但若未来下游应用领域发展速度放缓，整体市场增长停滞，或者公司无法快速挖掘新产品应用需求，及时推出适用产品以获取新兴市场份额，可能会面临业绩波动的风险。

（五）宏观环境风险

集成电路设计行业受国内外宏观经济、行业竞争和贸易政策等宏观环境因素的

影响较大，如果国内外宏观环境因素发生不利变化，可能造成集成电路材料供应和下游需求受限，从而对公司未来经营带来不利影响。

四、重大违规事项

2024 年度公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据如下：

金额单位：人民币元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	600,324,711.69	411,359,196.52	45.94
归属于上市公司股东的净利润	222,362,312.77	174,846,763.93	27.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,078,184.81	118,164,147.74	59.17
经营活动产生的现金流量净额	184,730,571.09	111,343,750.64	65.91
主要会计数据	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,552,935,807.39	2,391,118,333.31	6.77
总资产	2,649,250,831.90	2,493,688,579.18	6.24

2024 年度，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	2.41	1.89	27.51
稀释每股收益（元 / 股）	2.40	1.89	26.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	2.04	1.28	59.38
加权平均净资产收益率（%）	9.02	7.54	增加 1.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.63	5.09	增加 2.54 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	19.44	20.58	减少 1.14 个百分点

2024 年，公司实现营业收入 60,032.47 万元，较上年同期增长 45.94%；实现归

属于上市公司股东的净利润 22,236.23 万元，较上年同期增长 27.18%。

（一）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 6,991.40 万元，增加 59.17%。公司营业收入较上年同期增长 45.94%，主要系公司通过研发投入，不断增强产品优势，实现产品销售增长所致。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 59.17%，主要系营业收入增长所致。

（二）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,338.68 万元，较上年同期增长 65.91%，主要影响因素系：

1、营业收入同比增长 45.94%，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 21,502.44 万元；

2、随着营业收入增长，存货采购增加，以致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 10,278.18 万元；

3、人员增加及薪酬水平提高，以致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 2,497.69 万元。

六、核心竞争力的变化情况

（一）三重技术优势

公司在芯片技术、电机驱动架构、电机技术三个领域均拥有核心优势，并且积累了丰富的知识产权成果。三大技术领域的结合，形成了公司在 BLDC 电机主控及驱动芯片领域的核心竞争力。

（二）人才优势

公司核心技术团队分为芯片设计团队、电机驱动架构团队和电机技术团队。由于国内集成电路研发和高端电机驱动架构设计人才稀缺，公司从成立早期就制定了“自主培养、导师制、项目制”的人才培养战略，坚持内部培养、自主培养，建设技术精尖、富有创新活力的人才团队。报告期内，公司鼓励研发团队相互学习与分享，持续开展专题研讨、专题培训等活动，培养复合型研发人才，帮助后备级研发

人才不断成长，不断巩固和加强人才优势。

（三）系统级服务优势

基于芯片技术、电机驱动架构技术和电机技术三方面多年的技术积累，公司拥有向下游客户提供电机整体方案设计、电机系统优化和终端产品技术难题解决等系统级服务的能力。境内外电机控制芯片公司通常只专注于芯片设计和生产环节，市场推广和技术服务通常由其经销商、方案提供商负责，芯片公司与终端产品客户之间缺乏直接技术沟通，对客户的系统级支持较为薄弱。此模式既不利于芯片公司了解终端客户的应用需求，也不利于终端客户获取芯片公司深层次的技术支持。报告期内，公司通过互访、研讨、现场技术支持等方式持续加强与终端客户的技术沟通交流，以创新的算法技术帮助客户解决应用层面的技术难题，在为客户提供芯片产品的同时提供成熟的整体解决方案等系统级服务。

（四）客户粘性优势

经过长期的发展和积累，公司芯片产品的市场认可度逐步上升，公司通过终端制造厂商的产品测试，进入其供应链体系，在家电领域已经成功获得美的、海信、小米、海尔、松下、飞利浦、方太、华帝、九阳等国内外知名厂商的认可。公司凭借高质量的芯片产品以及系统级服务的优势，从电机分析和设计开始，协助客户开发系统级整体方案，并将具体需求通过算法、电路设计等方式反映至电机驱动控制专用芯片，为客户提供一揽子解决方案。报告期内，公司持续针对下游产业领域的需求，加强推进新产品、新技术的研发，不断巩固与增强客户黏度。

七、研发支出变化及研发进展

2024 年度，公司研发投入情况如下：

金额单位：人民币元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	116,730,255.33	84,674,314.14	37.86
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	116,730,255.33	84,674,314.14	37.86

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
研发投入总额占营业收入比例（%）	19.44	20.58	减少 1.14 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	不适用

本期研发费用为 11,673.03 万元，较上年同期增加 3,205.59 万元，增长 37.86%，主要系公司持续加大对研发投入力度所致：

- 1、公司持续关注研发团队建设，研发人员增加、薪资水平提升使得职工薪酬较上年增加 2,079.84 万元；
- 2、本期实施新的股权激励计划，使得股份支付费用较上年增加 572.51 万元；
- 3、本期材料、光罩等直接投入费用较去年增加 333.04 万元；
- 4、持续增加研发仪器设备、软件等，导致本期折旧与摊销费用较去年增加 231.70 万元。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

无。

九、募集资金的使用情况是否合规

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	类别	序号	金额
募集资金净额		A	1,728,461,819.89
截止期初累计发生额	募投项目投入	B1	212,937,221.71
	利息收入、理财收益扣除手续费净额	B2	63,260,265.19
	超募资金永久补充流动资金	B3	345,000,000.00
	未到期的现金管理金额	B4	952,500,000.00
本期发生额	募投项目投入	C1	78,540,584.12
	利息收入、理财收益扣除手续费净额	C2	23,153,050.29
	超募资金永久补充流动资金	C3	345,000,000.00

项目	类别	序号	金额
	超募资金回购股份	C4	20,020,767.98
截止期末累计发生额	募投项目投入	D1=B1+C1	291,477,805.83
	利息收入、理财收益扣除手续费净额	D2=B2+C2	86,413,315.48
	超募资金永久补充流动资金	D3=B3+C3	690,000,000.00
	超募资金回购股份	D4	20,020,767.98
	未到期的现金管理金额	D5	630,700,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4-D5	182,676,561.56
实际结余募集资金		F	182,676,561.56
差异		G=E-F	-

【注】：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 813,376,561.56 元，其中未到期的现金管理金额为 630,700,000.00 元。

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

报告期内，汪钰红通过芯齐投资间接持股减少 30,000 股；刘海梅通过芯齐投资间接持股减少 20,000 股；柏玉宏通过芯晟投资间接持股减少 930 股；林晶晶通过芯齐投资间接持股减少 21,300 股；黄丹红通过芯齐投资间接持股减少 18,000 股。除此之外，董监高及核心技术人员间接持股情况在报告期内未发生变化。

截至本报告期末，董监高及核心技术人员间接持股情况如下：BILEI 通过峰昭

香港间接持有公司 12,391,934 股；BICHAO 通过峰昭香港间接持有公司 10,739,677 股；SOH CHENG SU 通过峰昭香港间接持有公司 1,652,258 股。汪钰红通过芯齐投资、芯晟投资间接持有公司 94,026 股；刘海梅通过芯齐投资间接持有公司 62,300 股；柏玉宏通过芯晟投资间接持有公司 2,820 股；林晶晶通过芯齐投资间接持有公司 64,000 股；黄丹红通过芯齐投资、芯晟投资间接持有公司 58,026 股。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

十二、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



严 胜



孙允孜

